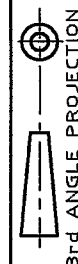


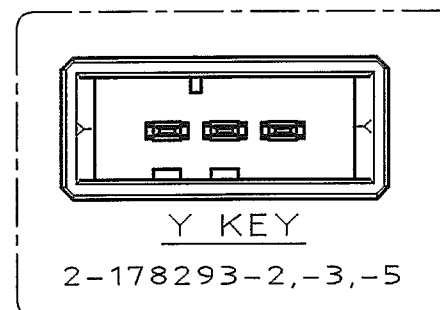
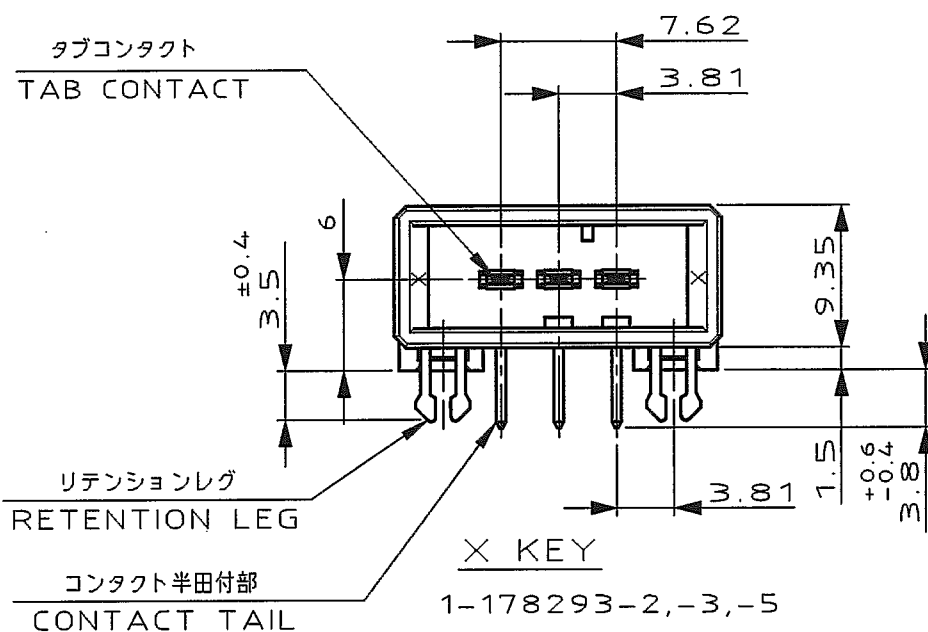
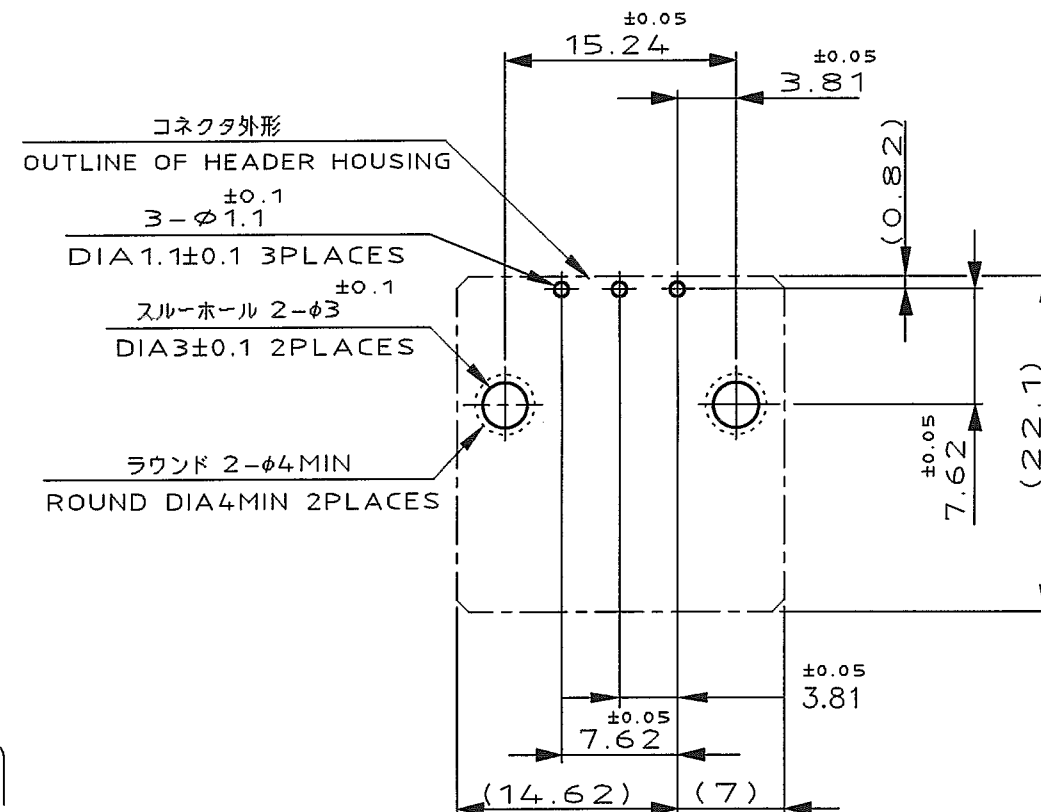
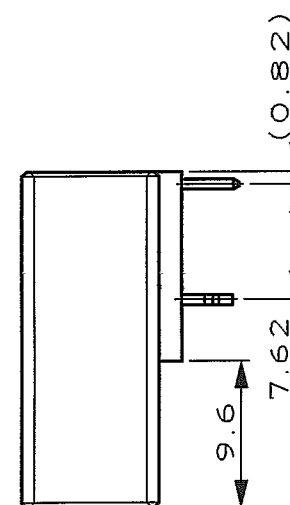
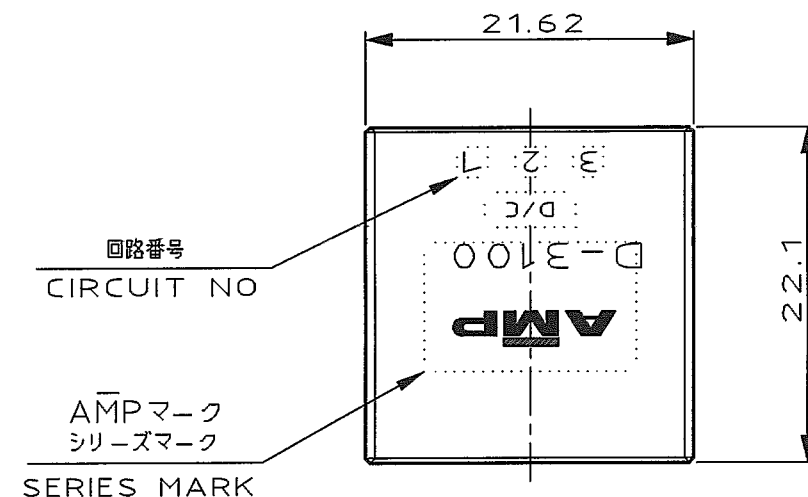
NUMBER 178293



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	1,2-178293-5
△6	△3	1,2-178293-3
△6	△2	1,2-178293-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	14APR 11	DR. 20/MAR/95 K.IKEDA	DE. 20/MAR/95 K.IKEDA	CHK. 23/MAR/92 S. MANABE	APP. 23/MAR/92 S. MANABE
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE				

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME			
mm (AWG -)		mm		3 POS SINGLE ROW			
MATERIAL		FINISH		HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100			
SEE NOTE		SEE NOTE		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
注記参照		注記参照					
DR.		DE.		SIZE		LOC	NUMBER
20/MAR'95		20/MAR'95		10mm : ±0.3		J	C= 178293
K.IKEDA		K.IKEDA		10mm 3mm下 : ±0.4			
CHK.		APP.		30mm 100mm下 : ±0.5		SCALE	REV.
23/MAR'92		23/MAR'92		角 度 : ±3°		2-1	C1
S. MANABE		S. MANABE					SHEET
							1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面